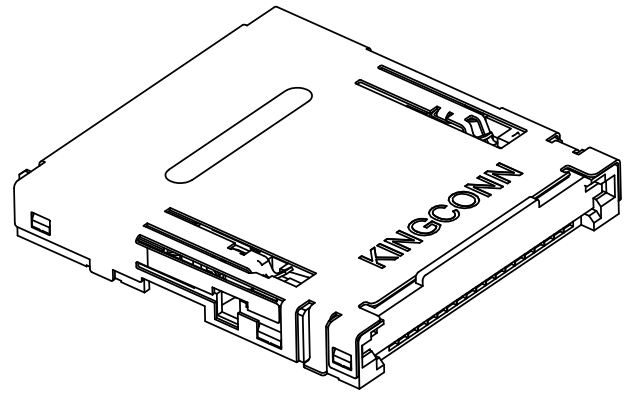


NOTES :

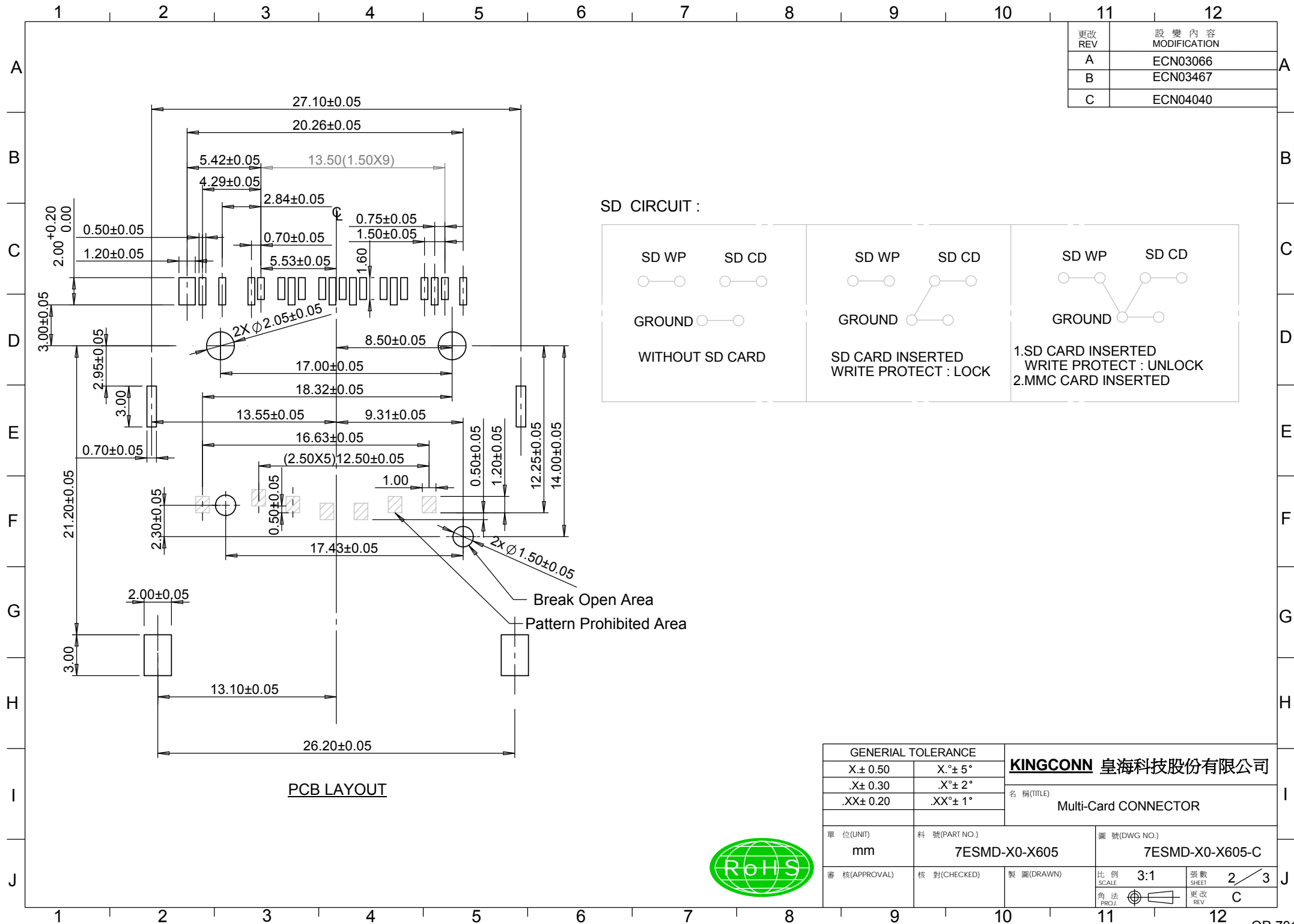
- MATERIAL :
INSULATOR : HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC , UL94V-0.
COLOR : BLACK
CONTACT : PHOSPHOR BRONZE.
- APPLICATION : SD&HS SD&SDHC&MMC&MS&MS PRO&MagicGate MS&MS-ROM&MS I/O Expansion&MS Duo&MS PRO Duo&MagicGate MS Duo&MS Duo-ROM Card
- PART NO : 7ESMD-X0-X605
0:TRAY
1:REEL
PLATING :
F CONTACT AREA : Gold Flash PLATED OVER Ni
SOLDER AREA : Tin PLATED OVER Ni
B CONTACT AREA : 10µ" Au PLATED OVER Ni
SOLDER AREA : Tin PLATED OVER Ni

更改 REV	設 變 內 容 MODIFICATION
A	ECN03066
B	ECN03467
C	ECN04040



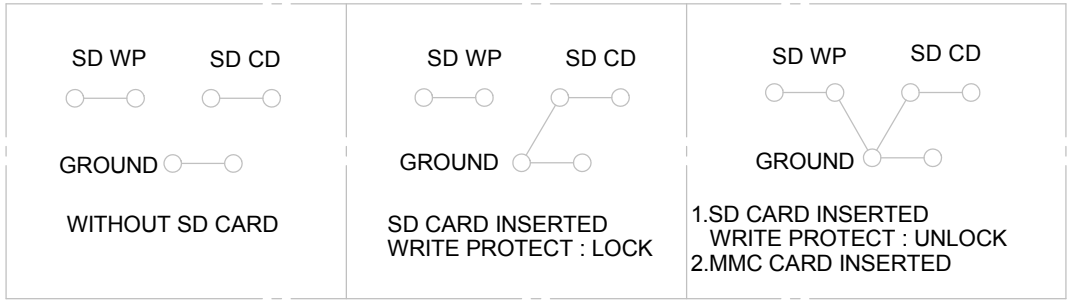
GENERAL TOLERANCE		KINGCONN 皇海科技股份有限公司	
X±0.50	X°±5°	名 稱(TITLE) Multi-Card CONNECTOR	
.X±0.30	.X°±2°		
.XX±0.20	.XX°±1°		
單 位(UNIT) mm	料 號(PART NO.) 7ESMD-X0-X605	圖 號(DWG NO.) 7ESMD-X0-X605-C	
審 核(APPROVAL)	核 對(CHECKED)	製 圖(DRAWN)	比 例 SCALE 1:1
			張 數 SHEET 1 / 3
			角 法 PROJ.
			更 改 REV C





更改 REV	設 變 內 容 MODIFICATION
A	ECN03066
B	ECN03467
C	ECN04040

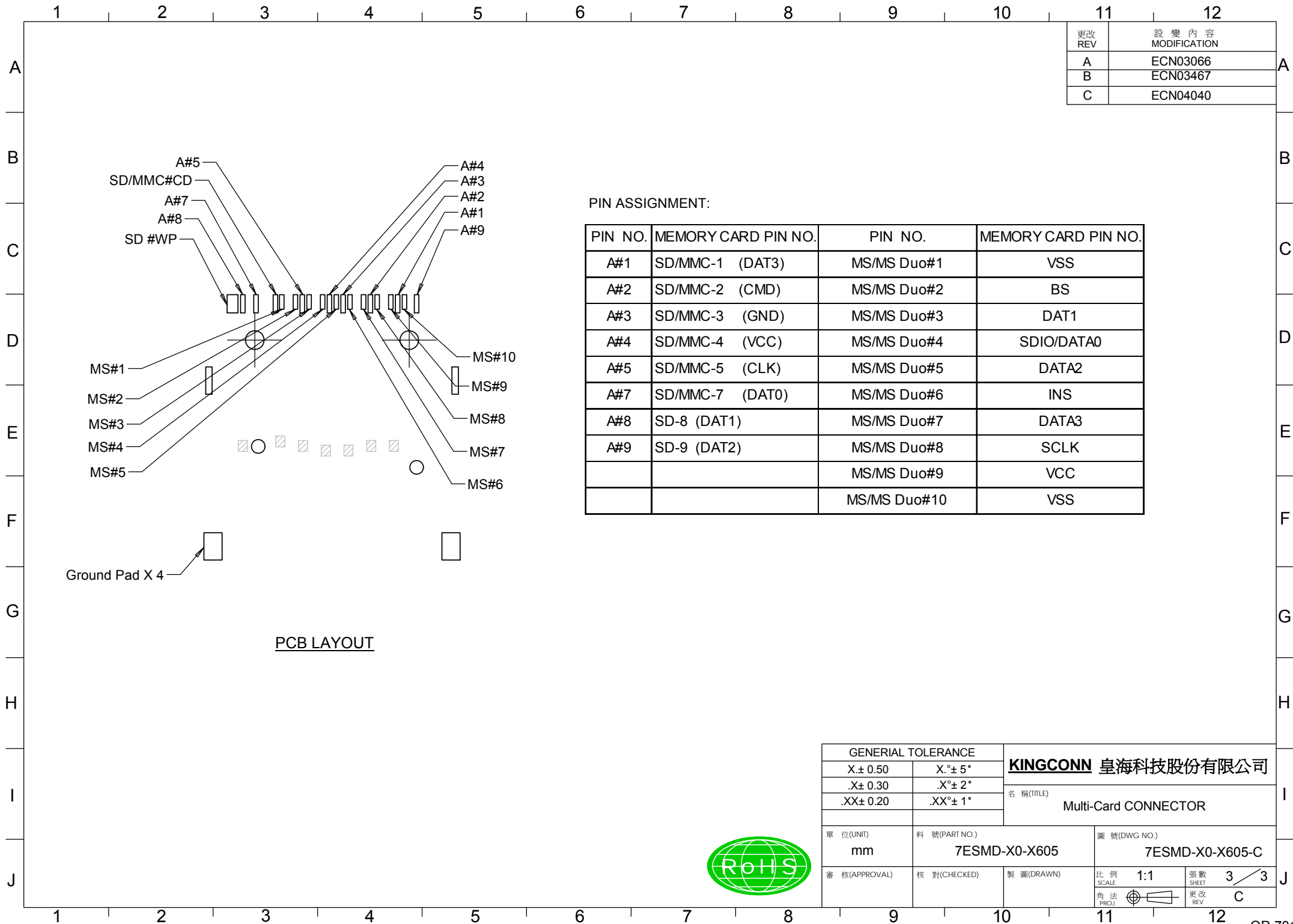
SD CIRCUIT :



GENERAL TOLERANCE		KINGCONN 皇海科技股份有限公司	
X±0.50	X°±5°		
.X±0.30	.X°±2°		
.XX±0.20	.XX°±1°		
單 位(UNIT) mm	料 號(PART NO.) 7ESMD-X0-X605	圖 號(DWG NO.) 7ESMD-X0-X605-C	
審 核(APPROVAL)	核 對(CHECKED)	製 圖(DRAWN)	比 例 SCALE 3:1
			張 數 SHEET 2/3
			角 法 PROJ 更改 REV C



更改 REV	設 變 內 容 MODIFICATION
A	ECN03066
B	ECN03467
C	ECN04040



PIN ASSIGNMENT:

PIN NO.	MEMORY CARD PIN NO.	PIN NO.	MEMORY CARD PIN NO.
A#1	SD/MMC-1 (DAT3)	MS/MS Duo#1	VSS
A#2	SD/MMC-2 (CMD)	MS/MS Duo#2	BS
A#3	SD/MMC-3 (GND)	MS/MS Duo#3	DAT1
A#4	SD/MMC-4 (VCC)	MS/MS Duo#4	SDIO/DATA0
A#5	SD/MMC-5 (CLK)	MS/MS Duo#5	DATA2
A#7	SD/MMC-7 (DAT0)	MS/MS Duo#6	INS
A#8	SD-8 (DAT1)	MS/MS Duo#7	DATA3
A#9	SD-9 (DAT2)	MS/MS Duo#8	SCLK
		MS/MS Duo#9	VCC
		MS/MS Duo#10	VSS

GENERAL TOLERANCE		KINGCONN 皇海科技股份有限公司	
X±0.50	X°±5°		
.X±0.30	.X°±2°		
.XX±0.20	.XX°±1°		
		名稱(TITLE) Multi-Card CONNECTOR	
單位(UNIT) mm	料 號(PART NO.) 7ESMD-X0-X605	圖 號(DWG NO.) 7ESMD-X0-X605-C	
審 核(APPROVAL)	核 對(CHECKED)	製 圖(DRAWN)	比 例 SCALE 1:1
			張 數 SHEET 3 / 3
			角 法 PROJ.  更 改 REV C

